股票简称：中微半导　　股票代码：688380

Cmsemicon

中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

（深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座 2008）

保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年八月四日

特别提示

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

本公司股票将于 2022 年 8 月 5 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为 44%、跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日内不设价格涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为 20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（三）流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为 40,036.5000 万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为 5,394.0251 万股，占本次发行后总股本的比例为 13.47%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

（一）报告期内公司产品主要集中在家电控制和消费电子领域

公司自成立之初即进入家电领域，报告期内在家电控制领域的收入占比较高，进入消费电子领域后其销售收入占比快速提升，报告期内家电控制和消费电子领域的收入占比分别为 96.57%、90.70%和 78.31%，家电行业及消费电子行业的需求波动会较大程度地影响对芯片的需求。公司进入电机与电池和传感器信号处理等领域的时间相对较短，占比显著低于家电控制领域和消费电子领域。由于公司在电机与电池和传感器信号处理等领域积累时间相对较短，相关业务尚处于起步阶段，产品丰富度和技术实力有待持续提升，如芯片市场产能紧张缓解或市场供求关系出现其他不利变化，公司在其他领域的收入增长可能存在一定不确定性。

（二）公司 MCU 芯片以 8 位为主，与国内外龙头企业存在一定差距

由于公司产品集中于家电控制领域，产品以 8 位 MCU 为主，报告期内公司 8 位 MCU 收入占比分别为 92.88%、86.40%和 84.27%，占比较高。公司 32 位 MCU 等大资源芯片收入占比虽逐年上升，但整体占比仍然较低。未来，随着智能化和物联网等技术的发展，相关电子产品对芯片算力资源要求将持续增加，预计对 32 位 MCU 的需求将持续增加。尽管公司已具备 32 位 MCU 芯片的设计能力，但公司 32 位 MCU 芯片的产品线仍待丰富。与国内外龙头企业相比，其产品线更为完整，应用领域更为丰富，市占率更高，并在一系列技术指标上存在优势。如果公司未通过技术研发及时丰富产品线、推出更多具有竞争力的 32 位产品，将对公司未来的市场竞争能力产生负面影响。

（三）公司 2021 年较高的毛利率不可持续的风险

报告期内，公司毛利率分别为 43.46%、40.42%和 68.86%，2019-2020 年销售毛利率保持总体稳定，2021 年，公司销售毛利率较 2020 年提升 28.44 个百分点，主要是因为受市场供需关系紧张影响，公司产品销售单价提升明显，同时公司将产能向高附加值产品和高毛利领域倾斜，未来若集成电路下游市场需求紧张缓解，或市场竞争环境、政策环境等因素发生重大不利变化，将对公司毛利率造成负面影响。受行业产能紧张影响，公司主要晶圆供应商华虹半导体和 GLOBALFOUNDRIES 在 2021 年陆续提高了晶圆报价，公司 2021 年新下单的晶圆价格显著上涨，但由于晶圆回货周期较长，加之人民币升值影响，尚未导致公司 2021 年实际入库晶圆的平均采购单价大幅上涨。此外，公司于 2020 年适当提前备货，降低了 2021 年晶圆成本上涨对公司产品成本的影响。如按照晶圆采购下单时间统计，2020 年下半年、2021 上半年及 2021 年下半年向主要晶圆供应商华虹半导体和 GLOBALFOUNDRIES 下单的晶圆金额分别为 2.32 亿元、1.28 亿元和 2.22 亿元，公司在 2020 年下半年提前备货的订单金额较高，上述晶圆统一折算为 8 寸片后的平均采购单价分别为 3,505.99 元 / 片、4,005.60 元 / 片和 4,223.38 元 / 片，2021 年新下单的晶圆价格显著上涨。若将 2021 年晶圆成本价格替换为截至 2021 年末各型号晶圆价格上涨后的下单价格进行测算，公司 2021 年主营业务毛利率将下降至 64.31%，上游晶圆制造及封测厂商因产能紧张等原因带来的涨价会拉低公司的毛利率水平。整体上看，公司 2021 年的高毛利率具有一定的短期特殊性，公司 2021 年较高的毛利率将不可持续，未来毛利率可能回归到此前的水平。2022 年 1-6 月，受半导体行业供需紧张缓解和新冠疫情等因素影响，公司毛利率预计有所降低。

（四）公司 2022 年 1-6 月业绩预计同比有所降低的风险

2022 年 1-6 月，公司预计实现营业收入为 43,000 万元至 47,000 万元，较上年同比变动 -19.60%至 -12.12%；预计实现归属于母公司股东的净利润为 3,600 万元至 9,200 万元，较上年同比变动 -86.08%至 -64.42%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 13,100 万元至 14,500 万元，较上年同比变动 -48.59%至 -43.10%。2022 年 1-6 月，公司在 2021 年第四季度以来半导体行业供应紧张逐步缓解的情况下，预计芯片销量较去年同期仍能实现一定增长。但由于半导体行业供需紧张缓解，下游市场供求关系发生变化，公司产品销售单价及毛利率有所降低。同时，2022 年 3 月份以来，受新冠疫情影响，公司的业务开展受到了一定影响，下游芯片市场需求出现短期异常波动。受半导体行业供需紧张缓解、新冠疫情等因素影响，公司 2022 年 1-6 月预计实现营业收入及净利润同比有所降低。此外，声光电科股票公允价值的潜在变动预计将拉低公司归属于母公司股东的净利润。

（五）供应商风险

公司属于 Fabless 模式集成电路设计公司，存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。近年来，随着半导体需求的增长以及产业链格局的变化，半导体行业的晶圆和封测需求快速上升，2020 年下半年起晶圆和封测产能逐步趋紧，采购价格呈上涨趋势。公司已通过加快产品及工艺迭代、在 55nm 等先进制程上进行 MCU 开发、与主要封装厂合资购置关键设备打通产能瓶颈、接洽新的供应商等方式应对产能紧张和上游价格上涨问题。如果未来产业链产能紧张的形势持续加剧，或公司未能有效应对采购价格上涨的影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。同时，为增加产能供应的稳定性，新加坡中微向 GLOBALFOUNDRIES 支付了 468.00 万美元的预付款，以在 2022 年 -2023 年预留一定生产产能，上述资金开支也占用了公司部分资金的流动性。此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此行业集中度较高。如果发行人的供应商发生不可抗力的突发事件或未能及时开拓新的供应商，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

2022 年 4 月 29 日，中国证监会印发《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]910 号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕212 号）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中微半导”，证券代码“688380”。本次发行后公司总股本为 400,365,000 股，其中 53,940,251 股股票将于 2022 年 8 月 5 日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2022 年 8 月 5 日

（三）股票简称：中微半导

（四）股票扩位简称：中微半导

（五）股票代码：688380

（六）本次发行完成后总股本：400,365,000 股

（七）本次 A 股公开发行的股份数：63,000,000 股，均为新股，无老股转让

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：53,940,251 股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：346,424,749 股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：6,217,292 股，其中中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股数为 1,944,264 股，约占首次公开发行股票数量的比例为 3.09%；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰中微半导芯成家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划获配股数为 4,273,028 股，约占首次公开发行股票数量的比例为 6.78%。

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

序号	股东名称	本次发行前		限售期限（月）
		持股数（万股）	占比	
1	YANG YONG	12,600.00	37.3483%	36
2	周彦	9,180.00	27.2109%	36
3	周飞	1,350.00	4.0016%	36
4	蒋智勇	1,620.00	4.8019%	12
5	罗勇	1,620.00	4.8019%	12
6	顺为芯华	1,498.50	4.4418%	36
7	顺为致远	1,498.50	4.4418%	12
8	南海成长	1,350.00	4.0016%	12
9	南海成长	135.00	0.4002%	17
10	中小企业发展基金	450.00	1.3339%	17
11	南山红土	360.00	1.0671%	12
12	达晨创鸿	315.00	0.9337%	36
13	国联科金	270.00	0.8003%	17
14	人才二号	202.50	0.6002%	36
15	聚泉投资	180.00	0.5335%	17
16	临创志芯	180.00	0.5335%	17
17	建发投资	180.00	0.5335%	17
18	云泽投资	180.00	0.5335%	36
19	重庆芯璧	162.00	0.4802%	17
20	深创投	90.00	0.2668%	12
21	高新投投资	90.00	0.2668%	36
22	加达投资	67.50	0.2001%	17
23	长劲石投资	45.00	0.1334%	12
24	李振华	45.00	0.1334%	17
25	达晨晨鹰二号	45.00	0.1334%	36
26	小禾投资	22.50	0.0667%	12
合计		33,736.50	100.00%	-

（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”

（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略配售部分，中信证券投资有限公司本次获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月；华泰中微半导芯成家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“中微半导员工资管计划”）本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。

2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计 277 个，对应的股份数量为 2,842,457 股，该等股票的锁定期为 6 个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本公司本次发行价格为每股 30.86 元，发行后股本总额为 40,036.50 万股，发行完成后市值为 123.55 亿元，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一套标准所规定的“预计市值不低于人民币 10 亿元”。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2022〕3-133 号”《审计报告》，发行人 2021 年度的营业收入为 110,903.05 万元，2021 年度净利润为 78,504.79 万元，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一套标准所规定的 “最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市审核规则》规定的上市条件。

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	中微半导体（深圳）股份有限公司
英文名称	Shenzhen China Micro Semicon Co., Ltd.
本次发行前注册资本	33,736.50 万元
法定代表人	周彦
住所	深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 A 座 2008
经营范围	一般经营项目是：集成电路，计算机软件产品，电子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主营业务	公司系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发，设计与销售，致力于成为以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制需所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
邮政编码	518052
电话	0755-26920081
传真	0755-86715044
互联网网址	http://www.mcu.com.cn
电子信箱	info@mcu.com.cn
董事会秘书	吴新元

二、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人

YANG YONG 直接持有公司 37.35%股份，通过顺为芯华间接持有公司 1.49%股份，合计持有公司 38.84%股份，任公司董事长，系公司的控股股东。周彦直接持有公司 27.21%股份，任公司董事兼总经理；周飞直接持有公司 4.00%股份，任公司董事；周彦、周飞系兄弟关系，YANG YONG、周彦、周飞三人在有限责任公司阶段及股份有限公司阶段均签署《一致行动人协议》，为一致行动人，三人系公司的实际控制人。《一致行动人协议》自签署之日起生效，并在交易所挂牌上市之日起 3 年内持续有效。同时约定若公司经营发展有需要，各方应协商延长协议有效期。且根据协议约定，YANG YONG 股权比例高于其他两位一致行动人，当各方不能达成一致意见时以 YANG YONG 的意见为准。具体简历如下：

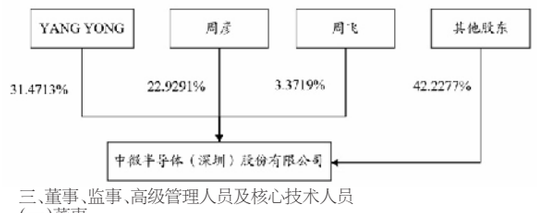
YANG YONG，男，1972 年出生，新西兰国籍，香港永久居留权，证件号码：LM07****，抚顺石油学院（现更名为“辽宁石油化工大学”，下同）学士、东南大学硕士。1992 年 9 月至 1993 年 9 月任中国石化集团重庆川维化工有限公司（原四川维尼纶厂）自动化仪表计量车间助工，1993 年 9 月至 1996 年 9 月任深圳市赛格集团有限公司工程师，1996 年 9 月至 2001 年 6 月任深圳市普特集成电路有限公司总经理，2001 年 6 月至今任公司董事长、总工程师。

周彦，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3302111970********，抚顺石油学院学士。1992 年 8 月至 1997 年 1 月任镇海炼油化工股份有限公司技术部仪表工程师，1997 年 1 月至 2001 年 6 月年任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2009 年 12 月至 2019 年 12 月任重庆中科芯亿达电子有限公司总经理，2001 年 6 月至今任公司总经理、董事。

周飞，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3301031973********，浙江工业大学学士。1995 年 9 月至 1998 年 12 月任中石化第三建设公司轴承厂和设计所技术与销售部工程师，1999 年 1 月至 1999 年 12 月任慈溪市弘微电子有限公司技术部工程师，2000 年 1 月至 2001 年 6 月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2001 年 6 月至 2017 年 12 月历任公司技术部工程师、财务部经理，2001 年 6 月至今任公司董事，2018 年 1 月至今担任公司 IT 部经理。

（二）本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：



三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员构成、提名人及任期情况如下：

姓名	职务	提名人	任期
YANG YONG	董事长	YANG YONG、周彦、周飞	2019.12.25-2022.12.24
周彦	董事、总经理	YANG YONG、周彦、周飞	2019.12.25-2022.12.24
周飞	董事	YANG YONG、周彦、周飞	2019.12.25-2022.12.24
王继通	董事、副总经理	YANG YONG、周彦、周飞	2019.12.25-2022.12.24
LIU ZEYU	董事	YANG YONG、周彦、周飞	2022.3.20-2022.12.24
陈凯	董事	南海成长	2020.6.1-2022.12.24
王毅	独立董事	YANG YONG、周彦、周飞	2020.12.26-2022.12.24
华金秋	独立董事	YANG YONG、周彦、周飞	2020.12.26-2022.12.24
吴敏	独立董事	YANG YONG、周彦、周飞	2020.12.26-2022.12.24

（二）监事

监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名，职工代表监事 1 名，股东代表监事 1 名。监事会成员构成、提名人及任期情况如下：

姓名	职务	提名人	任期
蒋智勇	监事会主席	YANG YONG、周彦、周飞	2019.12.25-2022.12.24
罗勇	监事	YANG YONG、周彦、周飞	2019.12.25-2022.12.24
冯超	监事	职工代表大会	2019.12.25-2022.12.24

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员 6 名，高级管理人员的构成、职务、提名人及任期情况如下：

姓名	职务	任期
周彦	总经理	2019.12.25-2022.12.24
王继通	副总经理	2019.12.25-2022.12.24
LIU ZEYU	副总经理、销售总监	2020.12.26-2022.12.24
MIAO XIAOYU	副总经理、技术总监	2020.12.26-2022.12.24
李振华	副总经理、产品总监	2020.12.26-2022.12.24
吴新元	董事会秘书、财务总监	2019.12.25-2022.12.24

（四）核心技术人员

公司核心技术人员的依据主要如下：1、拥有深厚且与公司业务相匹配的专业背景和丰富的工作经验；2、在公司研发、技术支持岗位上担任重要职务；3、对公司生产经营起到了重大作用与贡献。

根据上述标准，公司认定核心技术人员共三人，具体名单及认定依据如下：

序号	姓名	任职情况	认定依据
1	YANG YONG	董事长	1、拥有芯片设计相关的专业和研究背景；2、公司创始人，对公司生产经营有重大作用与贡献
2	MIAO XIAOYU	副总经理、技术总监	1、拥有近 20 年的模拟电路设计经验；2、公司技术总监
3	李振华	副总经理、产品总监	1、拥有芯片设计相关的专业和研究背景，拥有近 15 年的汽车电子经验；2、公司产品中心总监；3、负责芯片产品的架构设计研发及管理工作，主持开发了包括面向超低功耗和高可靠性、面向汽车级和面向家电控制领域的一系列芯片

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股票、债券情况

1、直接及间接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	本公司任职	直接持股比例	间接持股情况	合计持股比例
1	YANG YONG	董事长	37.35%	1.49%	38.84%
2	周彦	董事、总经理	27.21%	-	27.21%
3	周飞	董事	4.00%	-	4.00%
4	王继通	董事、副总经理	-	1.26%	1.26%
5	蒋智勇	监事会主席	4.80%	-	4.80%
6	罗勇	监事	4.80%	-	4.80%
7	冯超	监事	-	0.11%	0.11%
8	LIU ZEYU	董事、副总经理、销售总监	-	0.19%	0.19%
9	MIAO XIAOYU	副总经理、技术总监	-	0.19%	0.19%
10	李振华	副总经理、产品总监	0.13%	0.67%	0.80%
11	吴新元	财务总监、董事会秘书	-	1.16%	1.16%

上述人员的近亲属中持有公司股份的情况为公司董事长 YANG YONG 的父亲杨云安通过顺为芯华间接持有公司 0.03%股份；弟弟杨进通过顺为芯华间接持有公司 0.40%股份；弟弟杨斌通过顺为芯华间接持有公司 0.07%股份。公司监事罗勇的配偶金铭通过顺为致远间接持有公司 0.03%股份。

除上述情况之外，其他公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属未持有公司股份。

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的公司股份均不存在质押或被冻结的情况。

3、持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

（六）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、关于股份锁定及持股意向的承诺”。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

发行人在本次公开发行申报前共设立了两个员工持股平台：顺为芯华和顺为致远。

除上述情况外，公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况。

五、发行人员工持股计划及相关安排

（一）员工持股平台情况

公司股权激励平台包括顺为芯华和顺为致远，顺为芯华和顺为致远的持股主体的范围包括截至持股计划生效之日与中微半导或其下属公司存在劳动合同关系的员工。顺为芯华和顺为致远不在公司首次公开发行股票时转让股份，顺为芯华承诺其所持公司股份自公司股票上市之日起 36 个月内不转让，顺为致远承诺其所持公司股份自公司股票上市之日起 12 个月内不转让。顺为芯华和顺为致远未在基金业协会办理备案手续，顺为芯华穿透计算的权益持有人为 34 人，顺为致远穿透计算的权益持有人为 49 人，二者合并穿透计算的权益持有人为 82 人。

顺为芯华和顺为致远具体情况如下：

序号	公司名称	入股时间	入股价格（元 / 注册资本）	是否已计提股份支付
1	顺为芯华	2019 年 9 月	3.33	是
2	顺为致远	2019 年 9 月	3.33	是

1、顺为芯华

名称	顺为芯华（深圳）股资有限合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	丰泽一芯（深圳）贸易有限公司
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
出资额	1,108.89 万元
成立日期	2018 年 12 月 7 日
主营业务	股权投资业务

截至本上市公告书签署日，顺为芯华的具体出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类别	任职情况
1	丰泽一芯	466.11	42.03%	普通合伙人	-
2	王继通	233.10	21.02%	有限合伙人	中微半导副总经理
3	杨进	99.90	9.01%	有限合伙人	中山联发微副总经理
4	吴家洪	29.97	2.70%	有限合伙人	中微半导应用开发部副部长
5	谢正中	21.23	1.91%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
6	彭丽君	19.98	1.80%	有限合伙人	中微半导生产部主管
7	杨蕾	17.98	1.62%	有限合伙人	中微半导品质测试中心部长
8	杨斌	17.98	1.62%	有限合伙人	中微半导生产部配送员
9	郑华生	17.98	1.62%	有限合伙人	中微半导产品中心设计主管
10	谭石荀	17.48	1.58%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
11	黄杰明	16.48	1.49%	有限合伙人	四川中微芯成产品中心测试主管
12	梁文发	15.98	1.44%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
13	潘安	12.79	1.15%	有限合伙人	中微半导应用开发部副部长
14	谢宁林	12.49	1.13%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
15	廖亮	11.99	1.08%	有限合伙人	中微半导应用开发部部长
16	丁然	9.99	0.90%	有限合伙人	四川中微芯成产品中心设计主管
17	陈林林	9.99	0.90%	有限合伙人	四川中微芯成产品中心设计主管
18	杨云安	7.99	0.72%	有限合伙人	中微半导企业管理能力事员
19	刘能军	7.99	0.72%	有限合伙人	四川芯联发生产部车间主任
20	汤浩	7.99	0.72%	有限合伙人	四川中微芯成企业管理部主管
21	庞浩浩	6.99	0.63%	有限合伙人	中微半导品质测试中心测试员
22	杨晓明	6.99	0.63%	有限合伙人	四川芯联发生产部车间主任
23	李金庭	6.99	0.63%	有限合伙人	中微半导应用开发部工程师
24	谢艳	6.49	0.59%	有限合伙人	中微半导企业管理部行政专员
25	陈世军	5.49	0.50%	有限合伙人	中微半导生产部仓管员
26	黄兆兵	5.39	0.49%	有限合伙人	中微半导 IT 部信息员
27	毛琴	4.80	0.43%	有限合伙人	四川中微芯成财务中心出纳
28	吴中滔	3.00	0.27%	有限合伙人	四川芯联发生产部成测主管
29	张建泉	3.00	0.27%	有限合伙人	中微半导应用开发部工程师
30	夏泽武	1.67	0.15%	有限合伙人	中微半导应用开发部部长
31	钟成保	1.67	0.15%	有限合伙人	四川中微芯成技术中心主管
32	韩颖	1.00	0.09%	有限合伙人	中微半导销售中心品牌总监
总计		1,108.89	100.00%	-	-

顺为芯华的普通合伙人丰泽一芯基本情况如下：

名称	丰泽一芯（深圳）贸易有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	周彦
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
注册资本	500.00 万元
成立日期	2019 年 7 月 9 日
持股比例	丰泽芯旺持股 100%
经营范围	一般经营项目是：初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、美容美发产品（不含医疗器械）、珠宝首饰（不含裸钻）、文化艺术品、文化体育用品、电子产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车的零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）。许可经营项目是：预包装食品（不含复热）的零售

注：芯旺投资持有丰泽芯旺 100%股权，YANG YONG 持有芯旺投资 80.00%股权，LIU ZEYU 持有芯旺投资 10.00%股权，MIAO XIAOYU 持有 10.00%股权。

2、顺为致远

名称	顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	王继通
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
出资额	1,108.89 万元
成立日期	2018 年 12 月 11 日
主营业务	股权投资业务

截至本上市公告书签署日，顺为致远的具体出资情况如下：

序号	合伙人名称 / 姓名	出资额（万元）	出资比例	合伙人类别	任职情况
1	天津芯成	199.80	18.02%	有限合伙人	-
2	吴新元	183.15	16.52%	有限合伙人	中微半导董事会秘书兼财务总监
3	裘柳芳	99.90	9.01%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
4	陈晓	94.71	8.54%	有限合伙人	中微半导产品中心产品副总监
5	王继通	67.60	6.10%	普通合伙人	中微半导副总经理
6	李振华	66.60	6.01%	有限合伙人	中微半导副总经理兼产品总监
7	唐志强	29.97	2.70%	有限合伙人	中山联发微销售中心销售经理
8	王建军	29.97	2.70%	有限合伙人	中山联发微销售中心销售经理
9	朱巧云	27.64	2.49%	有限合伙人	中微半导财务中心财务副总监
10	冯超	26.97	2.43%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
11	罗峻	26.97	2.43%	有限合伙人	中微半导应用开发部副部长
12	宋灿	25.47	2.30%	有限合伙人	中微半导供应部主管
13	谭天易	24.98	2.25%	有限合伙人	四川中微芯成产品中心设计主管
14	朱华虎	18.73	1.69%	有限合伙人	中微半导产品中心工程师
15	蔡玉华	17.98	1.62%	有限合伙人	四川芯联发生产部封装主管
16	罗洪健	17.98	1.62%	有限合伙人	中微半导应用开发部部长
17	唐艳